

2024年06月06日



华鑫证券
CHINA FORTUNE SECURITIES

业绩提升超预期，半导体量测设备迎来增长新机会

—赛腾股份（603283.SH）公司动态研究报告

买入(首次)

投资要点

分析师：毛正 S1050521120001

maozheng@cfsc.com.cn

联系人：张璐 S1050123120019

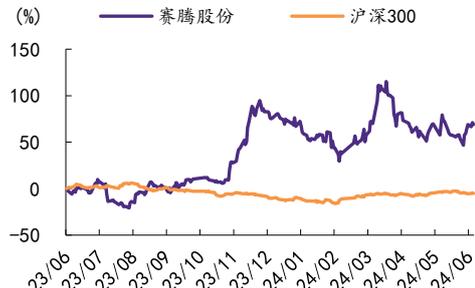
zhanglu2@cfsc.com.cn

基本数据

2024-06-05

当前股价(元)	70.4
总市值(亿元)	141
总股本(百万股)	200
流通股本(百万股)	186
52周价格范围(元)	33.35-90.54
日均成交额(百万元)	390.44

市场表现



相关研究

2023年营收利润大幅提升，三驾马车拉动销售规模

2023年，公司实现营业收入44.46亿元，同比增长51.76%；实现归母净利润6.87亿元，同比增长123.72%；实现扣非归母净利润6.68亿元，同比增长132.60%，营收利润大幅提升，主要得益于公司深耕智能制造装备行业的优质客户积累，同时2023年新增的客户带来了较大的销售额增长，销售规模同比持续增长且部分产品毛利率有所提升。公司专注于自动化设备领域，产品主要运用于消费电子、半导体、新能源等行业，消费电子为公司核心业务，公司正重点开拓半导体业务，同时发掘新能源板块汽车零部件的新机会，战略布局三条高景气赛道。

3C产品多样化需求，潜望式模组设备核心增量

消费电子板块是公司的核心业务领域，公司与核心客户深度绑定，公司的智能制造设备基本覆盖包括手机、平板电脑、耳机、手表、音响等终端产品。目前，公司的智能制造设备不仅应用于终端产品整机的组装、检测环节，纵向已延伸至前端模组段、零部件的组装、检测等环节，并深度参与客户新产品及零部件的研发，获得了领先的技术地位。随着3C产品的需求日益呈现多样化转变，潜望式镜头、折叠屏等新技术渗透率不断提升，2023年下半年苹果发布的iPhone 15系列首次采用了潜望式长焦镜头，公司作为潜望式模组设备供应商，深度受益于消费电子行业变化带来的核心增量。

收购OPTIMA进入量测设备，获得批量订单

公司在半导体行业布局产品主要为行业标准设备，如固晶设备、分选设备、晶圆包装机、晶圆缺陷检测机、倒角粗糙度量测、晶圆字符检测机、晶圆激光打标机、晶圆激光开槽机等等。公司通过收购全球领先的晶圆检测设备供应商日本OPTIMA进入晶圆检测及量测设备领域，并成为Sumco、三星、协鑫、奕斯伟、中环半导体等境内外知名晶圆厂商晶圆检测量测设备供应商。收购以来，公司高效完成技术整合，持续拓宽在高端半导体领域的设备产品线和在HBM等新兴领域的应用，并着力提升单台设备价值量。在半导体设备国产化浪潮和人工智能芯片快速发展的背景下，公司也迎来半导

体新制程需求增长新机会，积极配合一线国际客户的新需求，在晶圆边缘检测系统中开发明暗场结合激光光学技术，针对晶圆键合工艺中 thinning、trimming、bonding、coating 制程段增加了晶圆修边幅度、加工尺寸检测、晶圆 bonding 对准检测、粘合物工艺监测、EBR 监测以及 bonding 过程中出现的气泡、碎片、剥落、聚合物残留等新的缺陷检测功能，完善了对 HBM、TSV 制程工艺的不良监控，获得了客户的充分认可并成功获得批量设备订单。

■ 盈利预测

预测公司 2024-2026 年收入分别为 54.73、67.00、80.52 亿元，EPS 分别为 4.08、4.79、5.81 元，当前股价对应 PE 分别为 17.3、14.7、12.1 倍，公司布局消费电子+半导体+新能源，潜望式镜头渗透率的逐步提升、半导体设备国产化浪潮和人工智能芯片的快速发展有望给公司带来核心增量，首次覆盖，给予“买入”投资评级。

■ 风险提示

宏观经济的风险，产品研发不及预期的风险，行业竞争加剧的风险，下游需求不及预期的风险。

预测指标	2023A	2024E	2025E	2026E
主营收入（百万元）	4,446	5,473	6,700	8,052
增长率（%）	51.8%	23.1%	22.4%	20.2%
归母净利润（百万元）	687	817	959	1,164
增长率（%）	123.7%	18.9%	17.4%	21.4%
摊薄每股收益（元）	3.43	4.08	4.79	5.81
ROE（%）	30.6%	27.2%	24.6%	23.4%

资料来源：Wind、华鑫证券研究

公司盈利预测 (百万元)

资产负债表	2023A	2024E	2025E	2026E
流动资产:				
现金及现金等价物	619	1,535	2,515	3,784
应收款	765	795	844	860
存货	1,220	1,343	1,533	1,673
其他流动资产	509	569	640	719
流动资产合计	3,114	4,242	5,533	7,036
非流动资产:				
金融类资产	250	250	250	250
固定资产	845	796	745	697
在建工程	11	4	2	1
无形资产	194	240	286	330
长期股权投资	4	4	4	4
其他非流动资产	454	454	454	454
非流动资产合计	1,508	1,498	1,491	1,485
资产总计	4,621	5,740	7,024	8,522
流动负债:				
短期借款	161	161	161	161
应付账款、票据	822	1,081	1,354	1,637
其他流动负债	849	849	849	849
流动负债合计	2,264	2,622	3,013	3,427
非流动负债:				
长期借款	79	79	79	79
其他非流动负债	36	36	36	36
非流动负债合计	115	115	115	115
负债合计	2,379	2,737	3,129	3,542
所有者权益				
股本	200	200	200	200
股东权益	2,243	3,003	3,896	4,980
负债和所有者权益	4,621	5,740	7,024	8,522

现金流量表	2023A	2024E	2025E	2026E
净利润	693	842	989	1200
少数股东权益	6	25	30	36
折旧摊销	80	66	65	64
公允价值变动	-7	0	0	0
营运资金变动	602	146	80	179
经营活动现金净流量	1374	1079	1164	1479
投资活动现金净流量	-610	56	53	50
筹资活动现金净流量	152	-82	-96	-116
现金流量净额	916	1,054	1,121	1,412

资料来源: Wind、华鑫证券研究

利润表	2023A	2024E	2025E	2026E
营业收入	4,446	5,473	6,700	8,052
营业成本	2,360	3,048	3,820	4,617
营业税金及附加	58	55	67	81
销售费用	432	525	643	773
管理费用	365	465	569	684
财务费用	-7	-33	-60	-96
研发费用	388	493	603	725
费用合计	1,179	1,450	1,755	2,086
资产减值损失	-93	-50	-25	0
公允价值变动	-7	0	0	0
投资收益	-12	0	0	0
营业利润	802	935	1,098	1,334
加: 营业外收入	2	2	0	0
减: 营业外支出	1	1	0	0
利润总额	803	936	1,098	1,334
所得税费用	110	94	110	133
净利润	693	842	989	1,200
少数股东损益	6	25	30	36
归母净利润	687	817	959	1,164

主要财务指标	2023A	2024E	2025E	2026E
成长性				
营业收入增长率	51.8%	23.1%	22.4%	20.2%
归母净利润增长率	123.7%	18.9%	17.4%	21.4%
盈利能力				
毛利率	46.9%	44.3%	43.0%	42.7%
四项费用/营收	26.5%	26.5%	26.2%	25.9%
净利率	15.6%	15.4%	14.8%	14.9%
ROE	30.6%	27.2%	24.6%	23.4%
偿债能力				
资产负债率	51.5%	47.7%	44.5%	41.6%
营运能力				
总资产周转率	1.0	1.0	1.0	0.9
应收账款周转率	5.8	6.9	7.9	9.4
存货周转率	1.9	2.3	2.5	2.8
每股数据(元/股)				
EPS	3.43	4.08	4.79	5.81
P/E	20.5	17.3	14.7	12.1
P/S	3.2	2.6	2.1	1.8
P/B	6.5	4.8	3.7	2.9

■ 电子通信组介绍

毛正：复旦大学材料学硕士，三年美国半导体上市公司工作经验，曾参与全球领先半导体厂商先进制程项目，五年商品证券投研经验，2018-2020 年就职于国元证券研究所担任电子行业分析师，内核组科技行业专家；2020-2021 年就职于新时代证券研究所担任电子行业首席分析师，iFind 2020 行业最具人气分析师，东方财富 2021 最佳分析师第二名；东方财富 2022 最佳新锐分析师；2021 年加入华鑫证券研究所担任电子行业首席分析师。

高永豪：复旦大学物理学博士，曾先后就职于华为技术有限公司，东方财富证券研究所，2023 年加入华鑫证券研究所。

吕卓阳：澳大利亚国立大学硕士，曾就职于方正证券，4 年投研经验。2023 年加入华鑫证券研究所，专注于半导体材料、半导体显示、碳化硅、汽车电子等领域研究。

何鹏程：悉尼大学金融硕士，中南大学软件工程学士，曾任职德邦证券研究所通信组，2023 年加入华鑫证券研究所。专注于消费电子、算力硬件等领域研究。

张璐：早稻田大学国际政治经济学学士，香港大学经济学硕士，2023 年加入华鑫证券研究所，研究方向为功率半导体、先进封装。

■ 证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

■ 证券投资评级说明

股票投资评级说明：

	投资建议	预测个股相对同期证券市场代表性指数涨幅
1	买入	> 20%
2	增持	10% — 20%
3	中性	-10% — 10%
4	卖出	< -10%

行业投资评级说明：

	投资建议	行业指数相对同期证券市场代表性指数涨幅
1	推荐	> 10%
2	中性	-10% — 10%
3	回避	< -10%

以报告日后的 12 个月内，预测个股或行业指数相对于相关证券市场主要指数的涨跌幅为标准。

相关证券市场代表性指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以道琼斯指数为基准。

■ 免责声明

华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。本报告由华鑫证券制作，仅供华鑫证券的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告中的信息均来源于公开资料，华鑫证券研究部门及相关研究人员力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。我们已力求报告内容客观、公正，但报告中的信息与所表达的观点不构成所述证券买卖的出价或询价的依据，该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时结合各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就财务、法律、商业、税收等方面咨询专业顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华鑫证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露。

本报告中的资料、意见、预测均只反映报告初次发布时的判断，可能会随时调整。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，华鑫证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。华鑫证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告版权仅为华鑫证券所有，未经华鑫证券书面授权，任何机构和个人不得以任何形式刊载、翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若华鑫证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，华鑫证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成华鑫证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。如未经华鑫证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。华鑫证券将保留随时追究其法律责任的权利。请投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的华鑫证券研究报告。